

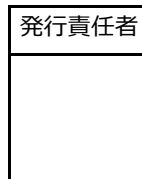
無洗浄対応リダクタ
For Non-Cleaning Application
RX262-110HO(V1a)(4750)

技術データ
Technical data

ニホンハンド株式会社
NIHONHANDA CO.,LTD

本社	東京都墨田区太平1-29-4 TEL 03-3624-5771 FAX 03-3624-5775
HEAD OFFICE	29-4 1-Chome,Taihei Sumida-ku, Tokyo 130-0012,Japan
電子材料研究所	千葉県市原市姉崎海岸82-1 TEL 0436-60-7688 FAX 0436-60-7689
Laboratory	82-1 Anesakikaigan Ichihara-city, Chiba-Prefecture 299-0107,Japan

発行責任者



RX262-110HO(V1a)(4750)特性一覧表
Properties of RX262-110HO(V1a)(4750)

項目 Item	代表特性 Typical Property	試験方法 Test method	ページ Page	
金属組成 Alloy	Sn62-Ag2-Pb	-	-	
フラックス含有量 Flux content	9.6% (標準品) Standard	-	-	
粒度・形状 Powder size・shape	25~45 μ m・球状 Sphere	ニホンハンダ [®] 試験法 NH METHOD	-	
固相線温度 - 液相線温度 Melting point, solidus line - liquidus line	179 $^{\circ}$ C - 179 $^{\circ}$ C	-	-	
ハライド含有量 Halide content	0.05%	JIS Z 3197	-	
広がり率 Rate of spread	235 $^{\circ}$ C	91.0%	JIS-Z-3197	-
銅板腐食試験 Copper plate corrosion test	合格 Pass	JIS-Z-3284	2	
クロム酸銀試験 Silver chromate paper test	合格 Pass	JIS-Z-3197		
銅鏡試験 Copper mirror test	合格 Pass	JIS-Z-3197		
絶縁抵抗試験 Electric insulation resistance test, SIR	40 $^{\circ}$ C90%RH 168hour	$1.0 \times 10^{13} \Omega$	JIS-Z-3284	3
	85 $^{\circ}$ C85%RH 168hour	$3.3 \times 10^9 \Omega$		
電圧印加試験 Voltage-applied moisture resistance, SIR (Bias DC45V)	40 $^{\circ}$ C90%RH 168hour	$1.6 \times 10^{11} \Omega$	IPC-TM-650	
	85 $^{\circ}$ C85%RH 168hour	$4.0 \times 10^9 \Omega$		
はんだボール試験 Solder balling test	良好 Good	ニホンハンダ [®] 試験法 NH METHOD	4	
粘着保持時間 100gf以上 Tackiness time of keeping 100gf minimum	16時間	JIS-Z-3284	5	
予備加熱時のダレ試験 Slump test in heating	0.4mm合格 0.4mmPass	JIS-Z-3284		
流動特性 マルコムスパイラル式 Fluidity characteristic, Spiral	粘度 Viscosity	200 Pa・s	JIS-Z-3284	6
	Ti値 Thxo.Index	0.58		
連続印刷性 Printing test	良好 Good	ニホンハンダ [®] 試験法 NH METHOD	7~8	

* 当技術資料に記載されたデータは代表値であり、保証値ではありません。

(Remarks) These physical property values of this technical sheet are not the specification of the product.

1. 銅板腐食試験 Copper Plate Corrosion Test

JIS Z 3284

合格 Pass



2. クロム酸銀試験 Silver Chromate Test

JIS Z 3197

合格 Pass



3. 銅鏡試験 Copper Mirror Test

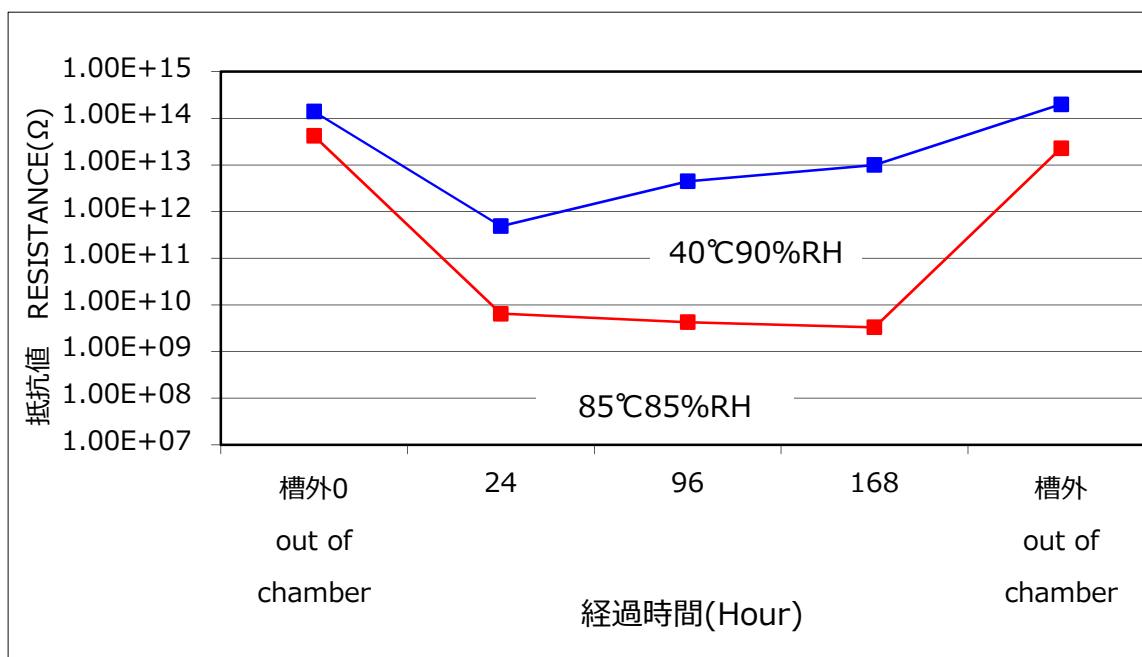
JIS Z 3197

合格 Pass



4. 絶縁抵抗試験 Electric Insulation Resistance Test

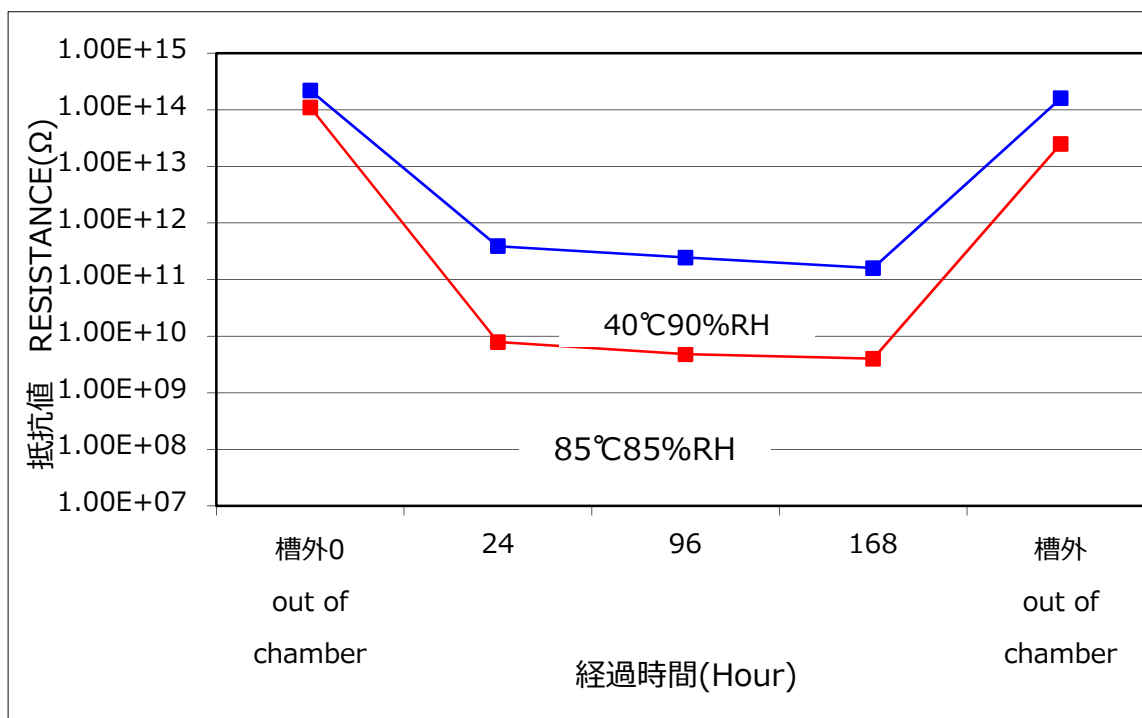
測定電圧:100V (test voltage of-100V DC)



5. 電圧印加試験 Voltage-applied Moisture Resistance Test

測定電圧:100V (test voltage of-100V DC)

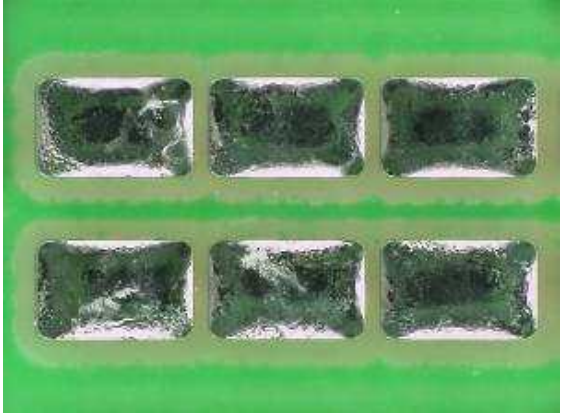

印加電圧:45V (bias potential of 45 volts DC)



6. はんだボール試験 Solder Ball Test

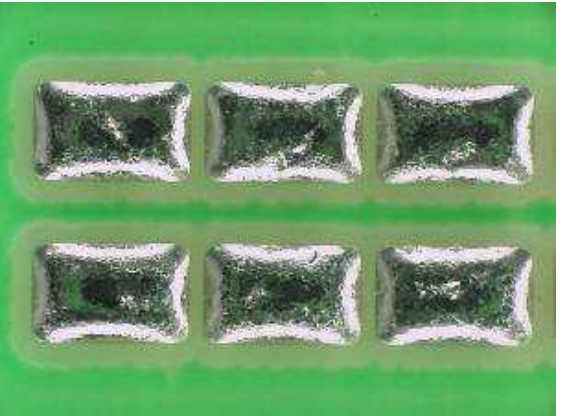

RX262-110HO(V1a)(4750)

リフロー条件 ホットプレート : 150°C60sec 230°C30sec(reflow condition : Hot-plate)

印刷直後リフロー Immediately reflow after printing	
ガラスエポキシ (Copper-Clad Epoxy/Glass Plate)	アルミナ (Alumina Plate)
	

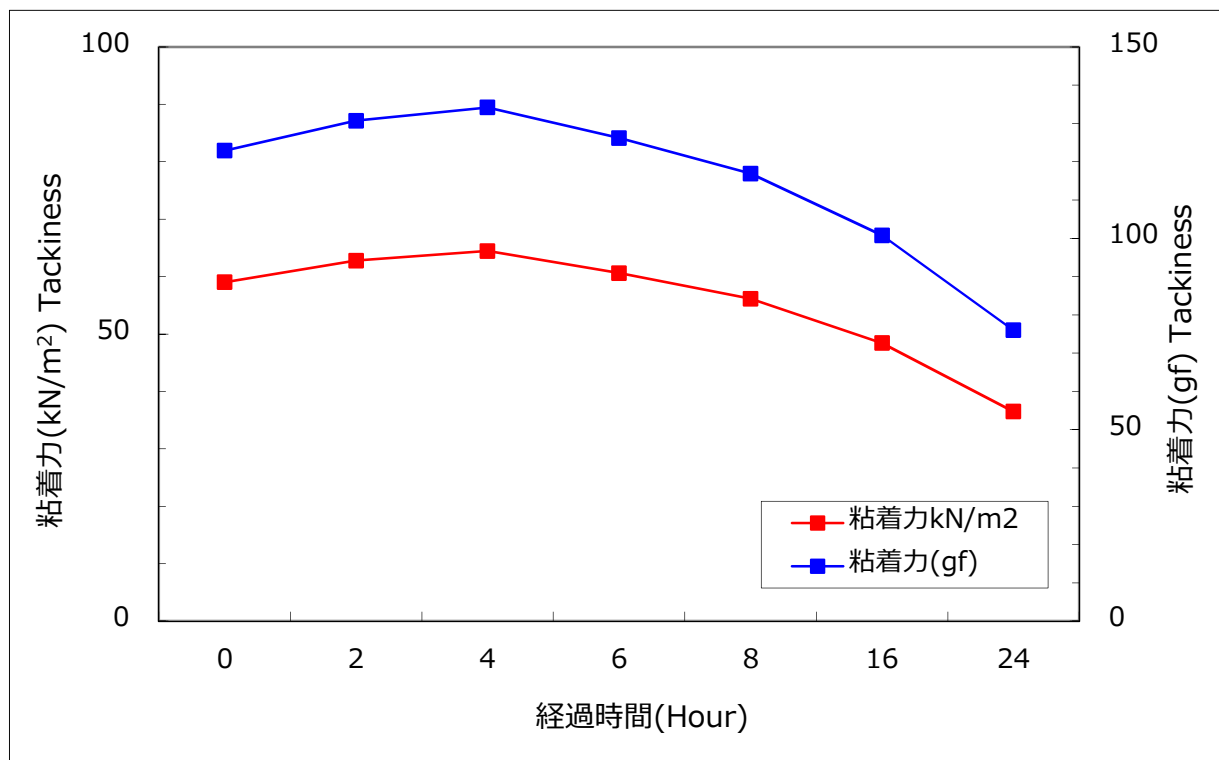
ガラスエポキシ (Copper-Clad Epoxy/Glass Plate)
印刷マスク(Mask) : 0.2t, NH-1

アルミナ (Alumina Plate)
印刷マスク(Mask) : 0.2t, 6.5φ

印刷後25°C50%RH24時間後リフロー Reflow 24hours after printing, conditioned in 25°C・50%RH room	
ガラスエポキシ (Copper-Clad Epoxy/Glass Plate)	アルミナ (Alumina Plate)
	

7. 粘着力経時変化 Tackiness

JIS Z 3284



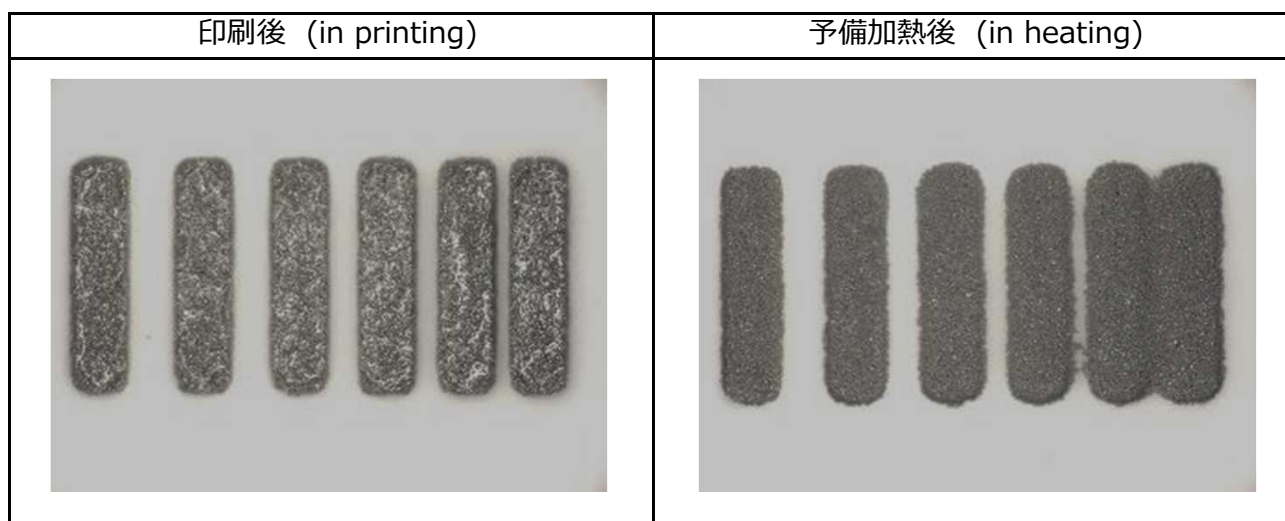
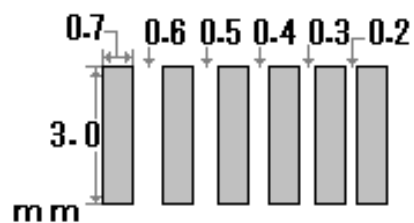
8. 予備加熱ダレ試験 Slump test in heating

印刷(Printing) : メタルマスク (Metal Mask) 0.2t

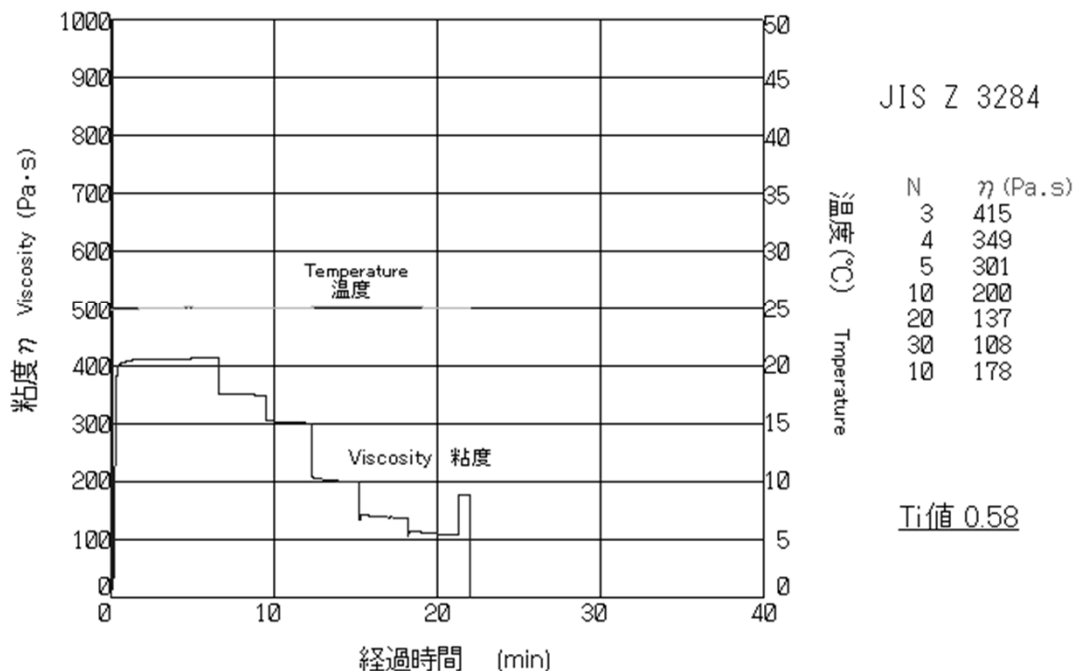
パターン(Pattern) : 右図参照(refer under fig.)

基板 (Plate) : アルミナ (Alumina) 50×50×0.8 t mm

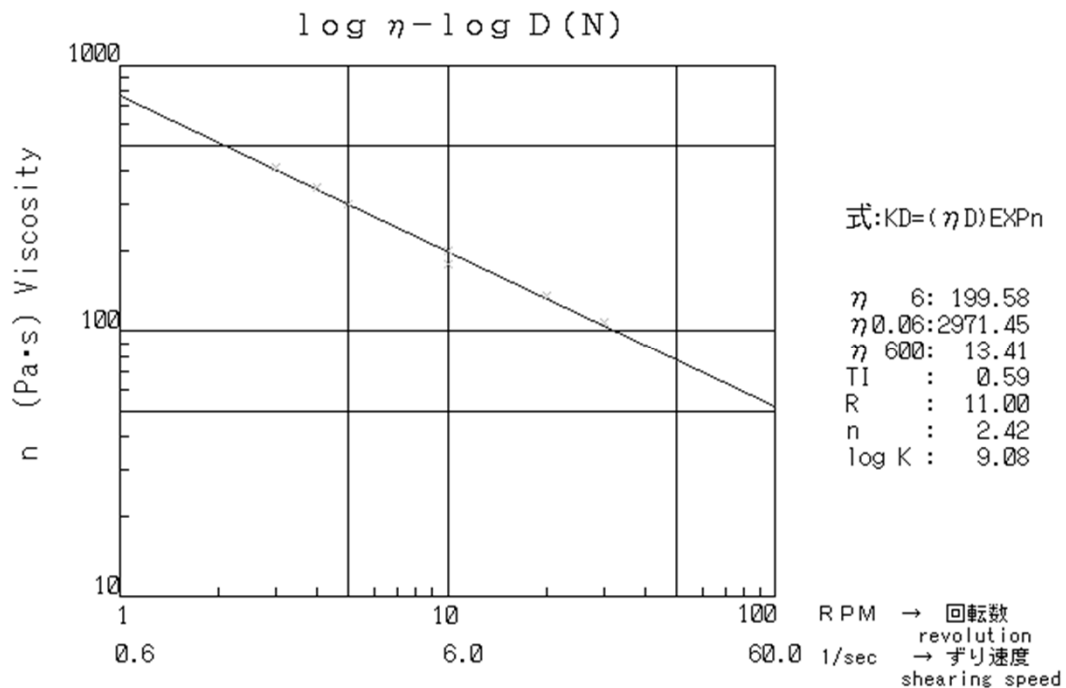
加熱(heating) : ホットプレート(Hot-plate) 150℃・60sec.



9. 流動特性 Fluidity Characteristic



log 粘度—log ずり速度



10. 連続印刷試験 Printing test

印刷条件

印刷機 : パナソニックファクトリーソリューションズ(株)SP28P-D
 スキージ : 平型ウルタスキージ 硬度90 角度60°北°ト` 20mm/sec 圧力 13.0×10^{-2} N
 版離れ速度 : 0.1mm/sec
 メタルマスク : NH-10 厚み150 μ m (株)プロセスラボミクロン製 レーザー
 印刷基板 : ガラエポ基板 厚み 1.6mm
 クリアランス : 0.1mm

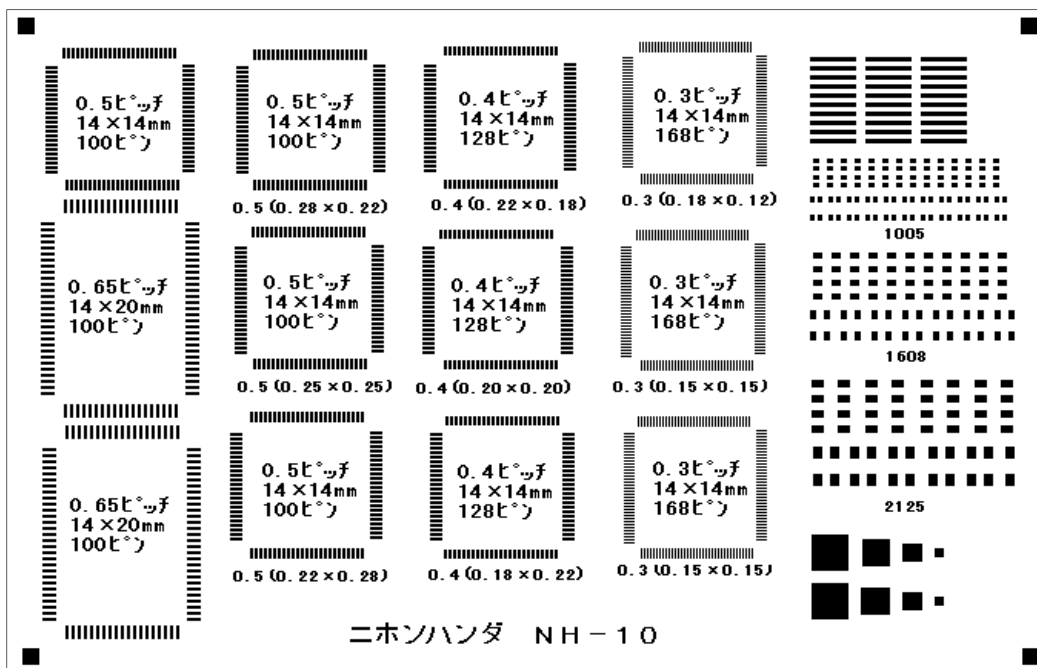
Condition of Printing

Printing Machine : SP28P-D, Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
 Squeegee : Polyurethane
 hardness : 90degree、Angle of Tip 60°
 Squeezing Speed : 20mm/sec Printing Pressure : 13.0×10^{-2} N
 Removing Speed of Mask : 0.1mm/sec
 Mask Pattern Arrangement : NH-10 Thickness : 150 μ m
 Additive type made by Process-Labo-Micron Co.,Ltds.
 Plate : Copper-Clad Epoxy/Glass Thikness:1.6mm
 Clearance between Plate and Mask : 0.1mm

観察部分 Evaluation

約1分間隔で50枚まで連続印刷し、1、30、50枚目の
 0.4mmピッチ (導体幅0.20mm) 部分の印刷形状を観察した。
 Print solder paste on successive 50 plates at one minute interval.
 And observe solder pattern of 0.4mm pitch area (pattern width=0.20mm)
 on 1st、 30th and 50th plate.

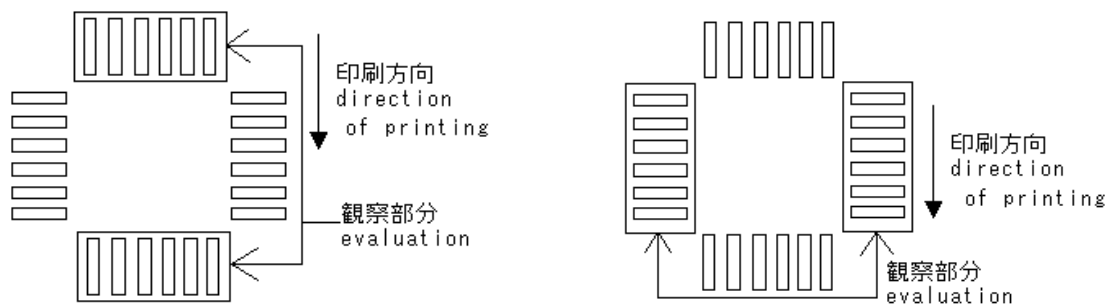
パターン Pattern



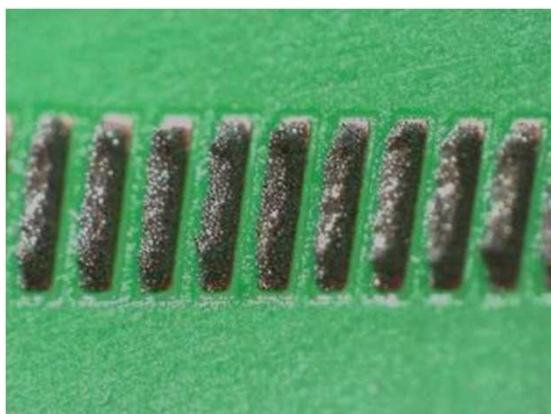
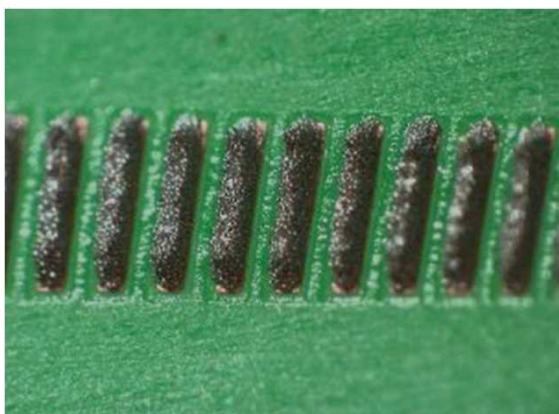
RX262-110HO(V1a)(4750)

印刷試験0.4mmピッチ

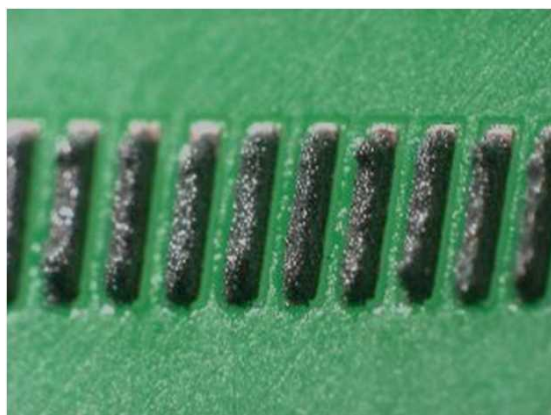
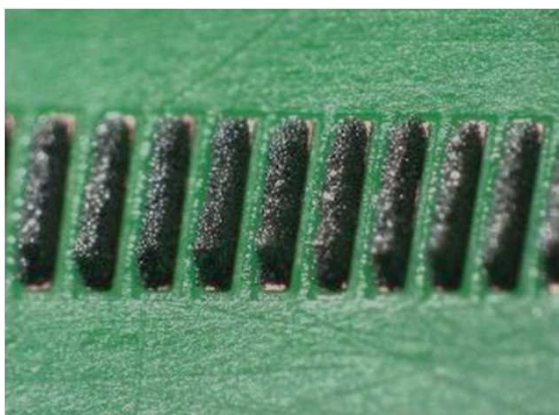
Printing Test 0.4mm pitch



1枚目 (1 Board printed)



30枚目 (30 Board printed)



50枚目 (50 Board printed)

